

KFR

Einbaukupplung nach IEC 60130-9, IP 40, mit Schraubverschluss, für Leiterplatten, für Frontmontage

- | | |
|--|---|
| 1. Temperaturbereich | -40 °C/+85 °C |
| 2. Werkstoffe | |
| Kontaktträger | PA GF |
| Kontaktbuchse 3- bis 8-polig | CuZn, untersilbert und vergoldet |
| Kontaktbuchse 12-polig | CuZn, unternickelt und vergoldet |
| Gehäuse | Zn-Druckguss, unterkupfert und vernickelt |
| Ringmutter | CuZn, vernickelt |
| 3. Mechanische Daten | |
| Steckkraft/Kontakt 3- bis 8-polig ¹ | < 5,0 N |
| Steckkraft/Kontakt 12-polig ² | < 5,0 N |
| Ziehkraft/Kontakt 3- bis 8-polig ¹ | > 1,2 N |
| Ziehkraft/Kontakt 12-polig ² | > 0,9 N |
| Kontaktierung mit Schutzart ³ | Steckern 033098, 033099, SV, WSV IP 40 |
| 4. Elektrische Daten | |
| Durchgangswiderstand | ≤ 5 mΩ |
| Weiteres siehe Tabelle | |

- ¹ gemessen mit einem polierten Stahlstift, Nennmaß 1,5 mm
² gemessen mit einem polierten Stahlstift, Nennmaß 1,0 mm nach DIN EN 60529
³ nur in verschraubtem Zustand mit einem dazugehörigen Gegenstück nach VDE 0110/IEC 60664

- *a Mutter lose beigelegt
nut enclosed separately
écrou ajouté séparément
- *b Lötpin für Leiterplattenbohrung
solder pin for bore hole of printed circuit board
plot à souder pour perçage de la carte imprimée
Ø 1,0 mm (KFR 30-81)
Ø 0,7 mm (KFR 120)
- *c Montagerichtung (Frontseite)
mounting direction (front side)
direction de montage (côté front)
- *d Einbauöffnung
port
ouverture d'emplacement

Leiterplattenlayouts siehe Seite 3
 Printed circuit board layouts see page 3
 Modèles des cartes imprimées voir à la page 3

Polbilder, von der Lötseite gesehen
 Pin configurations, solder side view
 Schémas de raccordement, vus du côté à souder



KFR 30



KFR 40



KFR 50



KFR 50/6



KFR 60



KFR 70



KFR 71



KFR 80



KFR 81



KFR 120

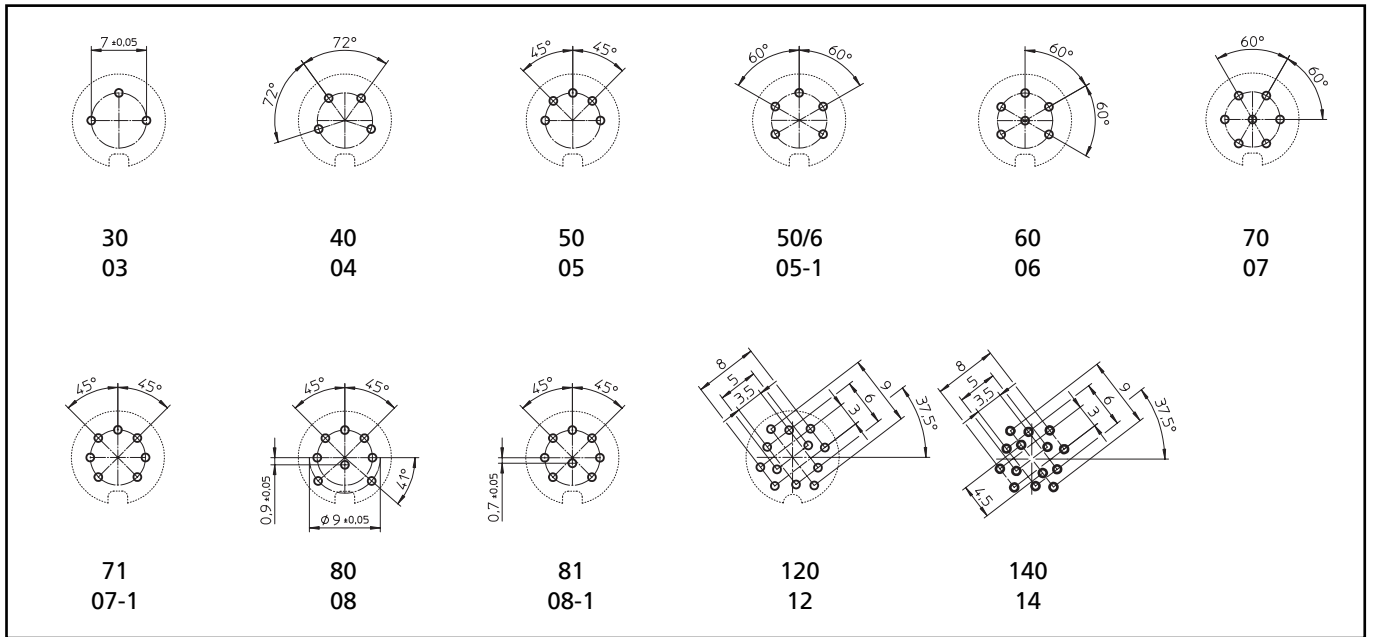
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
Circular connectors with threaded joint acc. to IEC 60130-9, IP 40
Connecteurs circulaires avec verrouillage à vis suivant IEC 60130-9, IP 40

| KFR | |
|--|---|
| Chassis socket acc. to IEC 60130-9, IP 40, with threaded joint, for printed circuit boards, for front mounting | |
| 1. Temperature range | -40 °C/+85 °C |
| 2. Materials | |
| Body | PA GF |
| Contact bush 3 to 8 poles | CuZn, pre-silvered and gilded |
| Contact bush 12 poles | CuZn, pre-nickel and gilded |
| Housing | Zn diecast, pre-coppered and nickel |
| Ring nut | CuZn, nicked |
| 3. Mechanical data | |
| Insertion force/contact 3–8 poles ¹ | < 5,0 N |
| Insertion force/contact 12 poles ² | < 5,0 N |
| Withdrawal force/contact 3–8 poles ¹ | > 1,2 N |
| Withdrawal force/contact 12 poles ² | > 0,9 N |
| Mating with | plugs 033098, 033099, SV, WSV |
| Protection ³ | IP 40 |
| 4. Electrical data | |
| Contact resistance | ≤ 5 mΩ |
| For further information please see table | |
| ¹ | measured with a polished steel pin, nominal thickness 1.5 mm |
| ² | measured with a polished steel pin, nominal thickness 1.0 mm |
| ³ | according to DIN EN 60529, |
| ⁴ | only in locked position with a proper counterpart according to VDE 0110/IEC 60664 |

| KFR | |
|--|--|
| Embase femelle suivant CEI 60130-9, IP 40, avec verrouillage à vis, pour cartes imprimées, pour montage de front | |
| 1. Température d'utilisation | -40 °C/+85 °C |
| 2. Matériaux | |
| Corps isolant | PA GF |
| Prise de contact 3 à 8 pôles | CuZn, sous-argenté et doré |
| Prise de contact 12 pôles | CuZn, sous-nickelé et doré |
| Boîtier | Zn moulé sous pression, sous-cuivré et nickelé |
| Écrou à anneau | CuZn, nickelé |
| 3. Caractéristiques mécaniques | |
| Force d'insertion/contact 3–8 pôles ¹ | < 5,0 N |
| Force d'insertion/contact 12 pôles ² | < 5,0 N |
| Force de séparation/contact 3–8 pôles ¹ | > 1,2 N |
| Force de séparation/contact 12 pôles ² | > 0,9 N |
| Raccordement avec | connecteurs mâles 033098, 033099, SV, WSV |
| Protection ³ | IP 40 |
| 4. Caractéristiques électriques | |
| Résistance de contact | ≤ 5 mΩ |
| Pour plus de détails, voir tableau s.v.p. | |
| ¹ | mesurée avec une tige d'acier poli, épaisseur nominale 1,5 mm |
| ² | mesurée avec une tige d'acier poli, épaisseur nominale 1,0 mm |
| ³ | suitivant DIN EN 60529, |
| ⁴ | uniquement à l'état verrouillé avec un propre pendant suivant VDE 0110/CEI 60664 |

| Bestellbezeichnung Designation Désignation | Polzahl Pôles Pôles | Verpackungseinheit (VE) Package unit (PU) Unité d'emballage (UE) | | | | | |
|--|---------------------------|--|---|--|---|---|--|
| | | | Bemessungsstrom Rated current Courant assigné | Bemessungsspannung ⁴ Rated voltage ⁴ Tension assignée ⁴ | Prüfspannung Test voltage Tension de claquage | Isolationswiderstand Insulation resistance Résistance d'isolement | Kontaktkapazität Contact capacitance Capacité de contact |
| | | | A | V AC | kV AC eff. | Ω | pF |
| KFR 30 | 3 | 50 | 5 | 250 | 2 | 10¹³ | ~ 2 |
| KFR 40 | 4 | 50 | 5 | 250 | 2 | 10¹³ | ~ 2 |
| KFR 50 | 5 | 50 | 5 | 60 | 1 | 10¹² | ~ 3 |
| KFR 50/6 | 5 | 50 | 5 | 250 | 2 | 10¹³ | ~ 2 |
| KFR 60 | 6 | 50 | 5 | 250 | 2 | 10¹³ | ~ 2 |
| KFR 70 | 7 | 50 | 5 | 250 | 2 | 10¹³ | ~ 2 |
| KFR 71 | 7 | 50 | 5 | 60 | 1 | 10¹² | ~ 3 |
| KFR 80 | 8 | 50 | 5 | 60 | 1 | 10¹² | ~ 3 |
| KFR 81 | 8 | 50 | 5 | 60 | 1 | 10¹² | ~ 3 |
| KFR 120 | 12 | 50 | 3 | 60 | 1 | 10¹² | ~ 3 |

Verpackung: im Karton
Packing: in a cardboard box
Emballage: dans un carton



Leiterplattenlayouts für Einbausteckverbinder, von der Bestückungsseite gesehen
 Printed circuit board layouts for chassis connectors, components side view
 Modèles des cartes imprimées pour embases, vus du côté à équiper